

兴业证券股份有限公司

关于

江苏点夺技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（福州市湖东路 268 号）

二〇二六年六月

保荐机构及保荐代表人声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏点夺技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况.....	2
二、发行人本次发行情况.....	15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	16
四、保荐机构与发行人关联关系的说明.....	17
五、保荐机构承诺事项.....	17
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明.....	18
七、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位的核查结论及依据.....	19
八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 上市条件的说明.....	28
九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.....	32
十、其他说明事项.....	33
十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论.....	33

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称	江苏点夺技术股份有限公司
英文名称	Jiangsu Dianduo Technology Co., Ltd.
注册资本	6,899.79 万元人民币
法定代表人	钟平
有限公司成立日期	2010 年 3 月 26 日
股份公司成立日期	2025 年 11 月 26 日
住所	启东市近海镇黄海路 5 号
邮政编码	226200
联系电话	0513-83833270
传真号码	0513-83601903
互联网网址	http://www.dianduo.com
电子信箱	gex@dianduo.com
经营范围	机电工程设计、施工，通风排气系统设计、施工，通风排气管道制造、销售、安装、调试，机电产品制造、销售、安装、调试，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
负责信息披露和投资者关系的部门	董秘办公室
信息披露和投资者关系负责人	葛馨
信息披露和投资者关系负责人电话	021-58543136

（二）发行人的主营业务

发行人是一家专注于半导体工艺排气系统研发、设计、制造与安装服务的国家级专精特新“小巨人”企业，在中国大陆半导体工艺排气系统领域处于领先地位。发行人以氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术、低泄漏耐腐蚀气密阀门

技术、高气密性管件柔性成型技术等核心技术为依托，构建了涵盖涂层风管、防腐风阀及配套连接件等关键部件以及现场安装与运维服务的完整产品与服务体系。发行人产品广泛应用于集成电路晶圆厂的工艺排气系统。工艺排气系统是半导体晶圆厂的关键厂务配套基础设施，承担着将芯片制造过程中产生的腐蚀性、可燃性、毒性及高温废气安全、稳定、低泄漏地从工艺机台引出至末端处理设施的关键职能，是保障晶圆厂高良率、高稳定性和生产安全的重要厂务基础设施。

发行人是中国大陆首家获得半导体业主广泛认可的 FM4922 认证的厂商。“点夺”是半导体工艺排气系统领域的高认可度品牌。中国大陆 22 家主流半导体厂商的 54 座主要晶圆厂中有 87% 使用了发行人的产品，交付产品的最长稳定运行年限已超过 18 年，发行人从未发生因产品气密性或可靠性问题导致的重大质量事件。发行人的半导体工艺排气系统产品在中芯国际、华虹集团、长鑫科技等国内头部晶圆厂要求苛刻的酸性、碱性排气系统中承担主要职责，也应用在海力士、美光、德州仪器、英飞凌、意法半导体、英特尔等业界知名厂商位于中国大陆及海外的工厂，产品交付至法国、意大利、日本、马来西亚、新加坡、美国等国家。

截至本上市保荐书出具日，发行人拥有发明专利授权 37 项，是行业标准化的重要推动者之一。发行人是 1 项国家标准的主要参编单位，正在参与 2 项国家标准和 3 项行业标准的制订工作。发行人具备业内少有的高一致性批量交付能力，具备日产 2,400 平方米高品质耐腐蚀涂层风管风阀的供应能力，可同时支持多座晶圆厂的建设。发行人作为工艺排气系统的供应商，参与了多个国内首条先进逻辑工艺产线、国内首条 12 英寸功率半导体代工产线、国内首条动态随机存取存储器（DRAM）芯片量产线、国内首条三维堆叠式 NAND 闪存量产线的建设。

发行人主营业务深度契合国家集成电路产业战略，所属厂务配套基础设施环节是保障国内晶圆厂顺利建设、稳定运行及国产化的关键支撑。报告期内发行人业绩持续增长。报告期各期，发行人营业收入分别为 44,583.49 万元、52,758.13 万元和 67,670.05 万元，年均复合增长率 23.20%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,742.42 万元、10,281.03 万元和 12,601.92 万元，年均复合增长率为 27.58%。截至 2026 年 5 月末，发行人在手订单余额（2025 年末正履行及 2026 年 1-5 月新增合同）13.01 亿元（含税），为发行人未来一定时期

的经营业绩提供了较好支撑。全球人工智能和算力需求正在快速增长，驱动半导体产业新一轮扩产周期，发行人正在积极投入研发并提升有效产能，以应对境内外客户的技术和市场需求。

（三）发行人的核心技术和研发水平

1、核心技术及研发情况

发行人深耕半导体工艺排气系统领域，始终坚持“技术驱动发展”的战略，针对集成电路行业对工艺排气系统的严苛要求（高稳定性、高防火等级、高耐腐蚀性、高密封性等），建立了一套覆盖系统设计、产品设计和产品生产的完整技术体系。发行人的研发活动围绕“提升高端个性化需求的响应能力”和“提升高性能、高一致性供应能力”这两大核心目标展开，在长期的客户个性化需求响应和针对性研发活动中，形成了三大核心技术，包括：氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术、低泄漏耐腐蚀气密阀门技术和高气密性管件柔性成型技术，具体情况如下：

（1）氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术

①技术概况

先进的涂层工艺是发行人半导体工艺排气系统业务的基础。涂料在实验室手工涂覆条件下普遍可达到优良性能，但在工业化生产条件下面临三大技术挑战：一是配方与工艺的匹配性，不同配方对涂装设备、固化曲线、环境参数的敏感度差异显著；二是复杂构件涂装均匀性，半导体排气系统大量采用弯头、变径、三通、多通道等异型件，传统涂装方式难以保证内外表面涂层厚度均匀；三是批量化生产稳定性，大规模工业生产节拍下，涂层易出现厚度不均、针孔、流挂、附着力下降等质量波动。

经长期的研发、实验和经验总结，发行人在涂层工艺领域研发出了自身独特的氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术。发行人的氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术是一套涵盖金属基材表面预处理、涂料粉末喷涂工艺、涂层烧结温度曲线控制和专属定制产线在内的工艺包。

②先进性及其表征

A.高质量一致性下的批量交付能力：涂层风管及三通、变径、弯头等定制异形件的高质量、高一致性大规模制备存在较高难度，尤其是异形件因焊缝多、曲率与内角复杂，烧结时易产生热场死角，难度尤为突出。发行人通过高气密性管件柔性成型技术保障基材表面质量，并自主建立涂层的多道次喷涂、道次间处理及烧结温度曲线精密控制方法，配合发行人定制的专用生产线，有效解决了涂层流挂、堆积、针孔、欠烧及层间结合不良等共性缺陷，将原本高度依赖技师经验的非标制造逐步转化为可控、可复制、可规模化交付的稳定工艺，在产品一致性与批量交付能力上形成显著竞争优势。发行人出厂产品都通过了涂层厚度 $250\pm 50\mu\text{m}$ （部分客户的特殊需求除外）、涂层“0气孔”和10级涂层附着力分级测试¹的质量控制要求。发行人在高质量的基础上实现了2,400平方米/日的涂层风管风阀供应能力，是业内少有的具备高一致性批量交付能力的厂商。

B.超大型产品的制备：半导体工艺制程设备有较高的排气需求，先进制程还涉及多道工序的大量循环，使得晶圆厂的工艺排气总风量非常大；总体上规模越大、制程越先进的晶圆厂，可能需要更大管径的工艺排气系统。超大型工艺排气系统零组件的生产工艺与一般产品存在明显差异，体现在前者需要同时攻克大尺寸金属基材成型的缺陷敏感性与大面积氟涂层的窄工艺窗口这两大难题。发行人的氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术使发行人解决了上述问题，进而能够批量制备直径3.6米的超大型涂层风管，超过目前市场的主要厂商的产品规格。

③专利保护情况

发行人已就氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术可进行专利化的部分申请了3项发明专利，分别于2023年10月、2024年3月和2024年4月公开，截至本上市保荐书出具日，上述发明专利申请仍处于实质审查状态。

(2) 低泄漏耐腐蚀气密阀门技术

①技术概况

阀门作为工艺排气系统中长期在强腐蚀环境下的运动部件，其调节精度、密

¹ “0气孔”指在2.5千伏高压电火花针孔检测下无气孔检出，10级指按照CNS10757测试方法下的涂层附着力等级。

封性与耐蚀可靠性直接决定了压力控制的有效性与系统安全，是工艺排气系统中技术含量高的核心零部件。半导体排气阀门在常规工业阀门基础上面临三大技术挑战：一是腐蚀与密封的耦合难题，阀门需在强酸、强碱腐蚀介质环境下长期保持极低泄漏率，而密封件恰是整阀中最易受腐蚀介质侵蚀的薄弱环节，腐蚀老化将直接导致密封失效；二是大口径密封难题，半导体厂务排气系统大量采用大口径风阀，口径越大，叶片在压差作用下的挠曲变形越大，沿叶片周边实现连续可靠密封的难度呈非线性上升；三是结构完整防腐难题，阀轴贯穿部位、紧固件、叶片边缘等位置存在天然的防腐覆盖盲区，任何金属裸露部位都可能成为腐蚀起始点，进而引发密封性能的链式劣化。

经长期的研发、实验和项目验证，发行人在阀门领域研发出了自身独特的低泄漏耐腐蚀气密阀门技术。该技术是一套涵盖叶片包覆密封结构设计、阀轴多重密封结构设计、阀体全包覆防腐结构设计及配套制造工艺在内的技术体系：在叶片密封方面，采用特定方式使用耐腐蚀橡胶对阀门叶片进行整体包覆，实现包覆层与叶片基体的可靠结合，叶片关闭时形成连续弹性密封面，同时包覆层本身构成叶片的防腐屏障，实现密封与防腐功能的一体化；在阀轴密封方面，在阀轴与阀体贯穿部位设置多道密封结构，逐级阻断腐蚀性气体沿轴向的泄漏路径；在整阀防腐方面，阀体内腔及内部紧固件均处于氟聚合物防腐涂层或耐腐蚀材料的完整覆盖之下，消除金属裸露部位。该技术与发行人氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术相互配合，共同保障阀门产品在强腐蚀工况下的长期密封可靠性。

②先进性及其表征

A.行业领先的气密性：阀门是工艺排气系统中最主要的运动密封部位，是整个排气系统气密链条上的最薄弱环节之一，“系统气密水平”很大程度上取决于阀门质量是行业共识，因此半导体客户对阀门供应商的密封技术能力提出了远高于常规工业领域的要求。发行人 1,600×914mm 规格风阀产品通过 AMCA 511 认证，阀门泄漏等级达到 Class 1。根据 AMCA 官方网站公开的认证查询情况，在同等口径规格下，发行人阀门产品的气密性认证等级高于已认证的同行业可比公司。

B.强腐蚀介质下的密封耐久性：通过阀门内部无螺栓结构与零部件一体喷涂防腐涂层相结合，发行人的阀门产品消除了内部紧固件这一主要腐蚀与失效源，

相较于采用钛合金或 PVDF 螺栓的传统结构,在长期酸碱腐蚀工况下的运行可靠性较强、使用寿命较长,发行人产品从未因腐蚀而出现压力控制精度不足或工艺废气额外泄漏的重大质量事故。

C.精确的工艺机台后端压力控制:应用发行人低泄漏耐腐蚀气密阀门技术生产的阀门产品可以长期、精准地将工艺机台后端压力控制在±15Pa 的范围内。

③专利保护情况

发行人已就低泄漏耐腐蚀气密阀门技术申请了多项相关专利,截至本上市保荐书出具日,其中 9 件已获授权,具体情况如下:

序号	专利名称	类型	专利号
1	一种多叶片密闭风阀	发明专利	ZL201510950075.0
2	包胶叶片、包胶模具以及包胶工艺	发明专利	ZL201810468545.3
3	一种阀体机构	发明专利	ZL201810469328.6
4	一种方阀	发明专利	ZL201910500390.1
5	一种带有导液功能的通风管用闸阀	发明专利	ZL202111053401.X
6	一种具有高效防腐密封性能的圆形密闭阀及其制作工艺	发明专利	ZL202210900294.8
7	一种无螺栓防腐结构的方形调节阀及其制作工艺	发明专利	ZL202210962696.0
8	一种手动风阀及其制造工艺	发明专利	ZL202310860781.0
9	一种具有缓冲且防止杂质堆积的管道阻隔阀	发明专利	ZL202410437558.X

(3) 高气密性管件柔性成型技术

①技术概况

高气密性管件柔性成型技术是发行人实现半导体工艺排气系统近零泄漏、高一致性和规模化交付的重要工艺基础。半导体工艺排气系统服务于晶圆厂洁净生产环境,系统气密性直接关系到工艺机台稳定运行、晶圆良率、人员及设备安全;在实际运行中,工艺废气可能因分子扩散、弯头与变径处局部涡流、机台启停瞬间局部正压以及长期受腐蚀介质侵蚀等因素产生泄漏风险,因此系统每一段管件、每一条焊缝及每一处连接界面均需具备较高的密封可靠性。

同时,半导体工艺排气系统具有“多品种、小批量、高定制化”的特点,单个晶圆厂项目涉及数千种不同规格的管件和阀门,且管件空间走向各不相同,传统大批量自动化制造方式难以直接适用。针对上述行业特点,发行人自主开发了

覆盖管件成型、气密性焊接、打磨整形和漏风检测的一体化柔性制造技术，通过可调式成型、夹持、焊接及检测工艺装备，实现不同口径、不同规格管件的快速切换生产，降低大口径及异形管件在成型、焊接和连接过程中的变形、错边、表面缺陷和泄漏风险，保障涂层前金属基材的表面质量与连接界面气密性，为后续氟聚合物涂层致密固化、现场安装调试及系统级近零泄漏提供关键支撑。

②先进性及其表征

A.定制化条件下的批间高一一致性：半导体工艺排气系统通常需根据客户厂房结构、机台布局、废气类型及风量需求进行定制化设计和生产，管件规格多、批量小、交付周期紧，对供应商的柔性制造能力和质量稳定性提出较高要求。发行人通过高气密性管件柔性成型技术，将成型、焊接、打磨、检测等环节纳入一体化工艺控制，实现不同口径、不同规格管件的快速切换生产，并减少传统手工制造模式下因操作经验差异导致的质量波动。该技术使发行人在定制化生产条件下实现了管件制造的批间高一一致性，是支撑发行人高品质涂层风管风阀日产 2,400 平方米规模化交付能力的关键工艺基础。

B.涂层前基材质量与后续防腐性能协同保障：半导体工艺排气系统大量采用弯头、变径、三通、多通道等异形件，管件成型精度、焊缝平整度、翻边及连接界面质量会直接影响后续涂层喷涂、烧结及最终气密性能。发行人通过该技术控制管件成型及焊接过程中的变形、错边、表面缺陷和泄漏隐患，保障涂层前基材表面状态的稳定性，为氟聚合物涂层均匀附着、致密固化及长期耐腐蚀性能提供基础条件。

C.系统级近零泄漏：发行人将“近零泄漏”作为产品核心控制目标。应用该技术生产并由发行人现场安装完成的洁净室工艺排气系统，在 1,000Pa 风压下漏风量低于 $0.06\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ ，优于欧洲 EN 12237 标准最高等级 Class D（约 $0.089\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ ）、美国 SMACNA 标准 CL1（约 $0.13\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ ）及国家标准对高压系统的要求（约 $0.29\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ ），亦显著优于客户合同通常要求的约 $0.44\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ 水平。该等指标体现了发行人在管件柔性成型、气密性焊接、连接密封及系统安装调试等全流程环节的综合技术能力。

③专利保护情况

序号	专利名称	类型	专利号
1	一种冲孔护形装置及冲孔设备	发明专利	ZL201810469326.7
2	一种直管对接焊的立焊装置	发明专利	ZL201910098740.6
3	对接管激光跟踪焊接系统及焊接工艺	发明专利	ZL201910500272.0
4	一种带有自密封检测功能的三通管焊接设备	发明专利	ZL202111053397.7
5	一种具有嵌套冲杆结构的小型曲面叶片冲压成型一体机	发明专利	ZL202210007902.2
6	一种便捷型半自动焊缝机	发明专利	ZL202310311221.X
7	适用于生产不同直径的钢带折弯设备	发明专利	ZL202310694127.7
8	一种形成金属翻边的冲压设备及其使用方法	发明专利	ZL202310696979.X
9	盲板全自动喷涂工艺生产线	发明专利	ZL202311103567.7
10	一种用于通风管道内壁自定位功能的磨削装置	发明专利	ZL202311325590.0
11	一种通风管道卷制成型设备	发明专利	ZL202311387472.2
12	一种具有防止变形凹陷功能的管道冲孔装置	发明专利	ZL202410433047.0
13	一种具有自寻定位的拼接管道用密封性检测装置	发明专利	ZL202410463848.1
14	一种阀门用自动化点焊系统	发明专利	ZL202410531356.1
15	一种管道用漏风检测系统	发明专利	ZL202410690680.8
16	一种阀门用碰焊设备	发明专利	ZL202410690682.7
17	一种三通阀门流道切屑清理装置	发明专利	ZL202411019239.3
18	一种自动化法兰冲压设备	发明专利	ZL202411063778.7
19	一种法兰零件冲压装置及冲压方法	发明专利	ZL202411079144.0
20	一种三通阀门端面自动铣削装置	发明专利	ZL202411091501.5

2、研发投入情况

报告期内，发行人研发投入情况如下表：

单位：万元

财务指标	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
研发投入	2,225.94	1,993.27	1,676.10
营业收入	67,670.05	52,758.13	44,583.49
研发投入占营业收入比重	3.29%	3.78%	3.76%

（四）发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
资产总额（万元）	98,349.58	92,567.58	74,435.03
归属于母公司所有者权益（万元）	54,830.89	37,302.04	25,833.80
资产负债率（母公司）（%）	41.60	57.86	63.81
资产负债率（合并）（%）	44.13	59.29	64.81
营业收入（万元）	67,670.05	52,758.13	44,583.49
净利润（万元）	11,723.15	10,156.25	7,587.50
归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,771.22	10,268.33	7,606.03
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,601.92	10,281.03	7,742.42
基本每股收益（元/股）	1.81	1.58	2.94
稀释每股收益（元/股）	1.81	1.58	2.94
加权平均净资产收益率（%）	27.81	33.16	30.84
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,772.05	1,898.35	-2,879.53
现金分红（万元）	1,068.75	-	5,907.64
研发投入占营业收入的比例（%）	3.29	3.78	3.76

（五）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）经营风险

①客户集中度较高风险

报告期各期，发行人向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 68.92%、67.85%和 74.63%。发行人客户集中度较高系由下游行业结构与业务模式共同决定：终端客户（业主）为半导体晶圆制造企业等高科技工业企业，晶圆制造产能高度集中于少数头部晶圆厂；直接客户为承接晶圆厂建设的总承包商或专业承包商，在国内集中于少数具备相关洁净厂房建设经验的头部企业，且通常以集团化方式经营，由其下属多家具备相应实施资质的子公司分别承接项目，按同一控制口径合并后进一步提高了客户结构的集中度。

受此影响，发行人经营具有单个系统交付合同金额较大的特点。若未来主要客户停止与发行人合作、其经营或承接项目规模出现重大不利变化，或发行人未能在主要客户的新建及扩产项目中持续获得合同，将对发行人经营业绩产生重大不利影响。

②供应链稳定性风险

基于产品性能一致性与规模采购的经济性，报告期内发行人产品的主要原材料之一——氟涂料（ETFE）均采购自科慕公司。科慕公司的母公司 Chemours（NYSE: CC）经营业绩存在波动，若其未来整体经营或财务状况发生重大不利变化，可能通过其在华子公司的传导，对发行人的供应链稳定性造成负面影响。

发行人使用新防腐涂料的产品需完成额外的 FM 认证，需要一定的周期；发行人已启动涂料供应商多元化的测试、认证工作，预计于 2027 年内完成认证。在多元化涂料完成认证并形成稳定供应之前，若现有供应发生中断，发行人将面临生产成本大幅上升或无法准时向客户交付的情况。发行人存在因主要原材料供应商断供导致的供应链稳定性风险。

③潜在的声誉冲击风险

半导体工艺排气系统承担腐蚀性、可燃性、毒性废气的输送功能，直接关系到晶圆厂的生产安全与产品良率，下游客户对产品质量与可靠性要求严苛，且系统安装后难以更换。尽管发行人已建立覆盖原材料检验、过程控制及出厂检验的质量管理体系，仍无法完全排除因不可预见因素导致产品出现质量问题或引发安全事故的可能性。如未来出现与发行人产品相关的安全事故或其他重大事故，将可能对发行人的声誉造成冲击，存在因声誉问题导致发行人业绩下滑的风险。

④成本波动风险

发行人的原材料主要包括不锈钢板材、氟涂料，发行人为客户提供安装服务需要采购外部劳务。若未来原材料及劳务价格出现大幅上涨，且发行人不能采取有效措施应对原材料及劳务价格上涨的影响，将会使发行人的经营成本大幅提升，进而造成发行人净利润下滑。发行人面临因成本波动导致业绩下滑的风险。

(2) 技术风险

①技术迭代风险

发行人的终端客户（业主）为半导体行业的头部厂商，随着全球半导体行业的高速发展，半导体行业的产品与技术也在快速迭代，因此要求发行人不断研发出符合甚至超前于半导体行业技术发展趋势的新产品、新设备。如果发行人未来不能保证稳定的研发团队、持续的研发投入或发行人新产品无法紧跟半导体行业的技术发展趋势，将导致发行人的产品在市场竞争中处于劣势，甚至面临市场淘汰，进而导致发行人的销售收入下降，对发行人经营业绩造成不利影响。

②研发人员流失风险

截至报告期末，发行人共有研发人员 54 人，相关研发人员是发行人研发能力的基础。若发行人未来出现重大的研发人员流失，可能破坏发行人的整体研发体系，将对发行人的研发能力造成负面影响；相关人员的流失还可能导致发行人的重大研发项目停滞或失败，造成发行人新产品或新技术的市场化落后于同行业公司或不能满足市场的最新需求，使发行人的市场竞争力相对下降，对发行人战略造成负面影响。

③研发成果不及预期风险

发行人的半导体工艺排气系统产品需长期承受高浓度酸碱及含氟废气的腐蚀，需维持高压差工况下的低泄漏率，相关工况对涂层、密封、结构等环节的工艺一致性与产品稳定性提出了非常高的要求。一项完整的新产品或新工艺研发，需经历“理论研究——工艺试制——性能测试——参数固化”的闭环，研发活动客观上存在工艺参数试错难度大、破坏性试验占比高、产业化存在不确定性且验证耗时漫长等特性。若发行人未来研发项目因技术路径调整、试验结果不及预期、参数固化困难、产业化条件不成熟等原因，未能如期实现既定技术目标，或在样品至产品的转化过程中出现重大障碍，则前期已发生的研发投入将无法形成有效产出，可能对发行人技术储备的延续性、新产品上市节奏产生不利影响。

(3) 财务风险

①应收账款坏账风险

报告期各期末，发行人应收账款余额分别为 28,451.82 万元、28,923.12 万元和 37,049.55 万元，呈增长趋势。发行人直接客户主要为承接晶圆厂建设的总承包商或专业承包商，以大型央企、上市公司及知名跨国集团为主，但仍存在应收账款的坏账风险。若未来发行人不能及时催款或下游客户的经营风险提升、偿债能力下降，将导致发行人应收账款坏账风险提升，从而影响发行人的经营业绩与现金流水平。

②存货（合同履行成本）跌价风险

报告期内，随着发行人经营规模的扩大，发行人存货余额总体处于较高水平，各期末存货余额占流动资产的比例超过 40%。发行人存货主要由合同履行成本构成，系发行人为履行合同而发生的各项成本。若未来项目无法顺利通过验收，发行人将面临存货跌价风险，进而造成发行人的利润下滑，对发行人经营业绩造成不利影响。

2、与行业相关的风险

(1) 半导体行业周期性波动风险

发行人所处行业的市场空间与下游晶圆厂资本开支高度相关，半导体行业具有显著的周期性波动特征。工艺排气系统建设属于前置性资本投入，对下游开支变化反应敏感。若全球半导体行业进入下行周期，或下游客户削减、推迟资本开支，发行人将面临新签订单下滑的风险，进而对经营业绩造成不利影响。

(2) 宏观环境波动风险

根据 WSTS、SEMI 等权威第三方机构的数据，当前半导体行业景气度相对较高，但宏观经营环境仍存在不确定性。发行人始终面对因宏观形势波动导致的供应链不稳定、原材料价格上涨、市场竞争加剧、客户需求暂停等情况的可能性，存在因相关情况导致发行人收入下降、成本上升，进而导致发行人经营业绩下滑的风险。

(3) 产业政策变动风险

发行人所属市场受到下游半导体行业资本开支的显著影响。近年来，国家及各级地方政府均出台了一系列的激励政策，支持半导体行业在人才、资金、技术、创新、市场等方面全方位发展。若未来国家及产业政策发生重大变动或国家及各级地方政府对半导体行业的政策扶持力度有所削减，可能对半导体厂商新建厂房、产线的活动产生负面影响，进而对发行人的业绩产生负面影响。

3、其他风险

(1) 募投项目不及预期的风险

发行人本次募投项目主要用于新建产线及现有产线的技改升级。此外，发行人本次募投项目还涉及化学品过滤器这一新产品，对发行人未来的市场趋势判断、市场推广能力及研发能力都提出了更高的要求。如果未来市场需求下降、发行人的市场开拓不力或客户与发行人终止合作，将导致本次募投项目的产能无法有效消化，发行人募投项目无法达到预期收益率，且资产的折旧、摊销费用将使发行人的净利润下降，对发行人经营业绩造成不利影响。

(2) 发行失败风险

发行人本次拟申请在深交所创业板公开发行股票，发行人需满足《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《创业板上市规则》等有关规定，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行能否通过深交所审核、取得中国证监会同意注册决定存在一定不确定性。

除发行人经营和财务状况之外，本次发行上市还将受到国际和国内宏观经济形势及各类突发事件影响，亦存在因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

(3) 实际控制人控制风险

截至本上市保荐书出具日，发行人实际控制人钟平通过上海点夺、南通湘麓、南通启光、上海平恩禾合计控制发行人 94.21%的表决权股份。钟平在发行人担任董事长及总经理职务，对发行人日常生产运行及决策起决定性作用。尽管发行人已建立健全了与公司治理、内部控制相关的各项制度，但如果未来实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等

方面实施不利影响，可能会对发行人及中小股东造成一定损害，因此，发行人存在实际控制人不当控制的风险。

二、发行人本次发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	2,300万股	占发行后总股本比例	25.00%
其中：发行新股数量	2,300万股	占发行后总股本比例	25.00%
股东公开发售股份数量	0.00万股	占发行后总股本比例	0.00%
发行后总股本	不超过9,199.79万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他发行方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立（A股）股票账户且符合相关法律法规关于投资者适当性条件的境内自然人、法人等投资者以及符合中国证监会、深交所规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	半导体智能环境设备及管道、配件生产基地项目		
	智能制造基地设备技术改造项目		
	研发中心建设项目		
	补充流动资金项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	无		

保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	无
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人

李立鸿先生，兴业证券投资银行业务总部业务董事，保荐代表人，10年保荐业务工作经验。曾经负责或参与阿莱德（301419）创业板IPO项目、芯联集成（688469）科创板IPO联席主承销项目。李立鸿先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

谢弘扬先生，兴业证券投资银行业务总部高级经理，保荐代表人，中国注册会计师，6年保荐业务工作经验。曾经参与绿通科技（301322）创业板IPO项目、阿莱德（301419）创业板IPO项目以及多个拟IPO项目的辅导、尽职调查工作。谢弘扬先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本项目无协办人。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括：高维锺、陈军、黄晓婷、周倩好、雷妍妍、卢珊、黄

喆珺、黄昊、钱越、马铭雪、何思谦、沈俊良、杨汉翔。

（四）联系方式

联系地址：福州市湖东路 268 号

电话：0755-2399 5226

传真：0755-2399 5179

四、保荐机构与发行人关联关系的说明

兴业证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书出具日：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况如下：

发行人股东兴证投资为本次发行的保荐机构兴业证券的全资子公司，兴证投资为发行人股东苏州聚源振芯有限合伙人之一，因此，兴业证券间接持有发行人 131.29 万股股份，占发行人本次发行前总股本的 1.90%。

除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了

解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

(二)保荐机构同意推荐江苏点夺技术股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

(三)保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、交易所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律监管。

六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明

保荐机构经过审慎核查，认为发行人本次发行已履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序。具体情况如下：

（一）本次发行的董事会审议程序

2026年4月30日，发行人召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案。

（二）本次发行的股东会审议程序

2026年5月17日，发行人召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等关于首次公开发行股票并上市相关的议案。

七、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位的核查结论及依据

（一）发行人所处行业符合创业板定位

发行人是国内领先的半导体工艺排气系统供应商。发行人产品作为半导体晶圆厂的厂务配套设施，承担工艺废气从机台至处理设施的安全、稳定、低泄漏输送功能，不直接参与晶圆制程，不接触晶圆，不属于半导体器件专用设备及关键材料范畴，故未归入“集成电路装备及关键材料”类别。发行人产品专为半导体工厂的排气控制需求研发、设计及生产制造，集中应用于半导体产业链（发行人90%以上收入来自半导体行业），其技术参数、产品规格、性能指标均根据半导体生产工艺特殊需求定制，属于《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）所列“集成电路净化室专用建筑材料、配套系统”中的厂务配套系统，归属于电子工业专用设备范畴。

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，发行人所属行业为“C35 专用设备制造业”下的“C3569 其他电子专用设备制造”，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》第五条规定的负面清单行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类行业，亦不属于从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

（二）发行人符合创业板定位相关指标要求

发行人符合创业板申报暂行规定第四条第二款的相关要求，具体如下：

评价指标	是否符合	备注
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	发行人最近三年累计研发投入 5,895.31 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	2025 年发行人营业收入为 6.77 亿元，超过 3 亿元，不适用营业收入复合增长率的要求

注：最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已在境外上市的红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。

（三）发行人的创新、创造、创意特征

半导体工艺排气系统呈现“投资占建厂总支出约 1%、重要性高”的非对称特征。半导体工艺排气系统服务于晶圆制造的厂务环境，遍布晶圆厂的主要生产区域，承担将工艺机台产生的腐蚀性、可燃性、毒性废气安全、稳定、低泄漏地输送至处理设施的功能，是保障晶圆良率、生产安全与设备稳定运行的关键厂务配套基础设施。下游终端客户和直接客户均对工艺排气系统产品的气密性、耐腐蚀性、运行稳定性、批量交付一致性等指标有远超出通用工艺排气系统的严格要求，半导体工艺排气系统已发展为具有独立技术体系、独立准入壁垒的专业化细分赛道，并非通用工业排气系统的简单延伸。

发行人的创新、创造和创意集中于该细分赛道的核心痛点——“如何在大批量定制化条件下，持续供应高性能、高一一致性产品”。发行人核心技术已实现量化可验证：量产出厂涂层产品满足膜厚 $250\pm 50\mu\text{m}$ 、涂层“0 气孔”及 10 级附着力的质控要求；安装完成的工艺排气系统在 1,000Pa 风压下漏风量低于 $0.06\text{L}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ ；系统级压力控制精度达 $\pm 15\text{Pa}$ 。具体特征情况如下：

1、核心技术实现突破，率先打破外资主导，推动半导体级工艺排气环节的本土化供应能力建设

发行人产品于 2007 年 1 月获得了 FM4922 的认证²，发行人是首家进入该细分领域的中国大陆背景厂商，由此打破了该领域长期由境外厂商主导的供应格局，为下游晶圆厂在采购成本、交付周期与本地化技术支持等方面提供了新的选择。

² 该认证系上海点夺于 2007 年取得，发行人与上海点夺已于 2023 年末进行了业务合并，下同。

半导体工艺排气系统服务于核心工艺设备的运行环境，且遍布晶圆厂全部生产区域，安装后难以更换或大修，是保障芯片良率、生产安全与设备稳定运行的关键厂务基础设施。全球先进制程晶圆厂的工艺排气系统曾长期由美国 Fab-Tech 公司及被授权使用 Fab-Tech 公司技术的相关企业提供服务。由于供应渠道受限，国内晶圆厂在产品采购成本、交付周期、本地化技术支持等方面均存在改善空间。

发行人产品已应用于逻辑芯片、存储芯片、功率半导体、模拟芯片等多种工艺类型的晶圆制造产线，为半导体厂商工艺技术升级提供稳定的厂务配套保障。发行人参与国内外多个标志性半导体厂商的标杆项目，包括：

(1) 逻辑芯片项目

国内首条高介电常数金属栅极（HKMG）工艺量产线、国内首条 FinFET 先进工艺量产线、国内首条制程节点探索性试产线。

(2) 存储芯片项目

国内首条动态随机存取存储器（DRAM）芯片量产线、国内首条新一代移动互联内存量产线、国内首条三维堆叠式 NAND 闪存量产线。

(3) 功率半导体项目

国内首条 12 英寸功率半导体代工产线、国内首条射频绝缘体上硅（RF-SOI）工艺规模量产线、全耗尽型绝缘体上硅（FD-SOI）嵌入式新型非挥发存储器量产线、300mm 超薄硅功率晶圆规模量产线。

上述产线对工艺排气系统性能的定制化要求程度较高，验证了发行人产品在极端工况下的稳定性。

发行人通过技术与工艺的不断探索，显著提升了半导体工艺排气系统的交付能力、响应速度和服务质量，为我国半导体产业链中厂务配套基础设施环节的本土化保障能力建设提供了重要支撑，为产业的自立自强提供了重要的厂务配套支持。

2、结合国内产业需求，持续迭代提升技术工艺能力

我国大陆半导体产业链在技术和供应链受到一定限制的背景下，形成了独特的工艺特点，即对工艺排气系统的大口径、高耐腐、高稳定性要求更为突出。另

外，国内半导体厂商的新建、扩产需求旺盛，对工艺排气系统的供应和交付速度有非常高的要求。因此，针对国内产业需求，发行人重点突破了以下关键技术：

(1) 氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术

先进的涂层工艺是发行人半导体工艺排气系统业务的基础。涂料在实验室手工涂覆条件下普遍可达到优良性能，但在工业化生产条件下面临三大技术挑战：一是配方与工艺的匹配性，不同配方对涂装设备、固化曲线、环境参数的敏感度差异显著；二是复杂构件涂装均匀性，半导体排气系统大量采用弯头、变径、三通、多通道等异型件，传统涂装方式难以保证内外表面涂层厚度均匀；三是批量化生产稳定性，大规模工业生产节拍下，涂层易出现厚度不均、针孔、流挂、附着力下降等质量波动。

经长期的研发、实验和经验总结，发行人在涂层工艺领域研发出了自身独特的氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术。发行人的氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术是一套涵盖金属基材表面预处理、涂料粉末喷涂、涂层烧结温度曲线控制和专属定制产线在内的工艺包。通过应用该项技术，发行人实现了：

①**高质量一致性控制**：所有发行人出厂产品都通过了涂层厚度 $250\pm 50\mu\text{m}$ （部分客户的特殊需求除外）、涂层“0 气孔”和 10 级涂层附着力分级测试³的质量控制要求。

②**高供应能力**：高质量涂层产品生产能力是限制业内厂商供应能力的主要瓶颈。发行人具备 2,400 平方米/日的高质量涂层风管风阀生产能力，是业内少有的具备高一致性批量交付能力的厂商。

半导体工艺排气系统呈现“投资仅占建厂总支出约 1%但重要性高”的非对称特征——其作为晶圆制造各环节的基础保障，系统稳定性直接影响产线连续性与生产安全，因此半导体客户及业主十分重视工艺排气系统供应商的产品稳定性与一致性。发行人经过二十余年的行业深耕，通过不断的项目积累，建立了覆盖表面处理、喷砂、喷涂、烧结全流程的工艺参数库，配合发行人自主研发、定制的生产线，发行人实现了对产品涂层性能、质量和一致性的高效控制，大幅提升了含氟粉尘工况下工艺排气管道的使用寿命，具备制备直径 3.6 米的超大型耐腐

³ “0 气孔”指在 2.5 千伏高压电火花针孔检测下无气孔检出，10 级指按照 CNS10757 测试方法下的涂层附着力等级。

蚀涂层工件的批量制造能力。

(2) 低泄漏耐腐蚀气密阀门技术

阀门是半导体工艺排气系统中含运动部件的关键组件，承担排风量调节、系统切换等功能，其性能直接决定系统的气密水平与运行安全。半导体排气阀门在常规工业阀门基础上面临三大技术挑战：一是腐蚀与密封的耦合难题，阀门需在强酸、强碱腐蚀介质环境下长期保持极低泄漏率，而密封件恰是整阀中最易受腐蚀介质侵蚀的薄弱环节，腐蚀老化将直接导致密封失效；二是大口径密封难题，半导体厂务排气系统大量采用大口径风阀，口径越大，叶片在压差作用下的挠曲变形越大，沿叶片周边实现连续可靠密封的难度呈非线性上升；三是结构完整防腐难题，阀轴贯穿部位、紧固件、叶片边缘等位置存在天然的防腐覆盖盲区，任何金属裸露部位都可能成为腐蚀起始点，进而引发密封性能的链式劣化。

经长期的研发、实验和项目验证，发行人在阀门领域研发出了自身独特的低泄漏耐腐蚀气密阀门技术。该技术是一套涵盖叶片包覆密封结构设计、阀轴多重密封结构设计、阀体全包覆防腐结构设计及配套制造工艺在内的技术体系：在叶片密封方面，采用特定方式使用耐腐蚀橡胶对阀门叶片进行整体包覆，实现包覆层与叶片基体的可靠结合，叶片关闭时形成连续弹性密封面，同时包覆层本身构成叶片的防腐屏障，实现密封与防腐功能的一体化；在阀轴密封方面，在阀轴与阀体贯穿部位设置多道密封结构，逐级阻断腐蚀性气体沿轴向的泄漏路径；在整阀防腐方面，阀体内腔及内部紧固件均处于氟聚合物防腐涂层或耐腐蚀材料的完整覆盖之下，消除金属裸露部位。该技术与发行人氟聚合物涂层界面预处理与致密固化技术相互配合，共同保障阀门产品在强腐蚀工况下的长期密封可靠性。

通过应用该项技术，发行人实现了：

①国际权威认证的卓越泄漏等级：发行人 1,600×914mm 规格风阀产品通过 AMCA 511 认证，阀门泄漏等级达到 Class 1。由于阀门口径越大密封难度越高，发行人在该口径规格上取得 Class 1 等级，处于行业领先水平。根据 AMCA 官方网站公开的认证查询情况，在同等口径规格下，发行人阀门产品的气密性认证等级高于已认证的同行业可比公司。

②强腐蚀介质下的密封耐久性：发行人实际应用是客户工厂的产品从未因腐蚀而出现压力控制精度不足或工艺废气额外泄漏的重大质量事故。

阀门虽为工艺排气系统中的单体组件，但其作为系统中的运动密封部位，是整个排气系统气密链条上的最薄弱环节之一，“系统气密水平”很大程度上取决于阀门质量是行业共识，因此半导体客户对阀门供应商的密封技术能力提出了远高于常规工业领域的要求。发行人经过多年的行业深耕，依托覆盖密封结构设计、防腐结构与批量制造工艺的完整技术积累，所生产的工艺排气系统相关阀门产品具备在高腐蚀工况下长期稳定运行的性能，与发行人涂层风管及其他零组件共同构成完整的半导体工艺排气系统解决方案，是发行人工艺排气系统产品±15Pa 压力精准调控和系统级气密性能得以实现的关键支撑之一。

(3) 高气密性管件柔性成型技术

半导体工艺排气系统具有“多品种、小批量、高定制化”特征——单个晶圆厂项目涉及数千种不同规格的管件和阀门，且管件三维空间走向各不相同，传统的大批量自动化方案无法直接适用。

针对这一行业特点，发行人自主开发了覆盖成型、气密性焊接、打磨和检测的一体化柔性制造技术（发行人在上述每个环节都获得了相关发明专利），实现同一设备对不同口径管件的快速切换生产。

该项技术使发行人在定制化生产条件下实现了管件制造的批间高一一致性。在气密性方面，发行人在客户洁净室内安装完成的工艺排气系统在 1,000Pa 风压下漏风量低于 $0.06\text{L}/(\text{s m}^2)$ ，优于欧洲 EN 12237 标准最高等级 Class D（约 $0.089\text{L}/(\text{s m}^2)$ ）、美国 SMACNA 标准 CL1（约 $0.13\text{L}/(\text{s m}^2)$ ）及国标对高压系统的要求（约 $0.29\text{L}/(\text{s m}^2)$ ）。

(四) 发行人的科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

1、科技创新：用多学科发明解决半导体产业厂务配套难题

半导体工艺排气系统对耐腐蚀性、气密性、压力控制精度的极致要求构成了显著的技术壁垒和认证壁垒。发行人在涂层工艺、精密机械制造、自动化、复合材料应用及学科领域内进行了长期的研发，在相关学科内进行了发明创造，将不同学科的技术应用于半导体产业配套领域，解决了工艺排气系统领域半导体厂务配套的难题，打破了进口产品主导的格局，为我国半导体产业提供了稳定可靠的

配套支持。

2、模式创新：从单一零部件制造商升级为系统化交付供应商

工艺排气系统的建设有先行不可逆、缺陷来源多样化、对晶圆生产环境重要性高的特点，发行人将自动化焊接技术、材料涂层技术、系统与产品设计技术系统性应用于半导体厂务排气领域，实现了从最终需求、现场环境、设计深化、产品分解、工艺安排、生产调度到质量追溯的全流程管理，从单一的零部件制造商升级为“前期设计深化+中期定制化生产+后期安装调试”的系统化交付供应商。发行人不仅能够提供标准化及定制化产品，还能够根据客户的具体需求进行定制化设计，甚至能够为业主提供前端管网布局优化建议，实质降低工艺排气系统的全生命周期成本与风险，协助业主将工艺排气领域的缺陷风险最小化，保障洁净室生产环境安全稳定。

3、新旧产业融合：实现通用工业排气技术向半导体高端配套的升级

通用工业排气系统主要用于满足环境保护相关要求，具有废气浓度低、废气类型单一的特点。而半导体工艺排气系统的首要作用是确保半导体生产环境的洁净度、连续性和稳定性，防止各类废气倒灌污染洁净室及工艺设备，从而影响产品良率与生产效率，同时将各类复杂的酸碱气体、有毒气体安全输送至中央处理设备，两者的技术路径和应用要求存在本质差异，半导体工艺排气系统已形成独立的专业化技术体系。

长期以来，先进制程半导体工艺排气系统主要由外资企业主导。发行人自设立以来专注于该领域，实现了通用工业排气技术向半导体高端配套的升级，实现了新旧产业的融合发展。

（五）发行人具有成长性

发行人是国内最早进入半导体工艺排气系统领域的本土企业，2007年即通过 FM4922 认证，依托核心技术进入国内外主流晶圆厂供应链体系并保持长期稳定合作；报告期内主营业务收入由 44,436.34 万元增长至 67,444.29 万元，复合增长率 23.20%，客户黏性与历史业绩为收入增长提供支撑。

1、全球市场持续增长，发行人境内外业务协同发展

(1) 行业市场空间广阔，长期成长趋势明确

全球人工智能和算力需求的爆发式增长，正在驱动半导体产业新一轮扩产周期。同时，出于全球供应链重构的考量，各国加大对晶圆制造的支持力度。根据 SEMI（国际半导体产业协会）的相关研究报告，未来全球半导体产业资本开支将持续保持较高复合增长率。

(2) 本土化供应保障与产业链自立自强背景下，发行人将充分把握国内市场发展机遇

我国作为工业制造业大国和晶圆消费大国，制造底蕴和下游市场需求将不断为晶圆制造提供技术进步的路径和产品验证的基础。在我国半导体自立自强的战略引导下，主流晶圆代工厂和 IDM 厂商加快了产能扩张与技术迭代的步伐。根据国际半导体产业协会 2026 年 3 月发布的《全球晶圆厂建设展望报告》，2026-2028 年全球 12 英寸晶圆厂建设投资规模将持续增长，中国大陆产能占比将稳步提升至 30% 左右；同时，国内晶圆厂在技术上正逐步追赶国际领先厂商并缩小与国际领先技术的差距。因此，在制造业升级、晶圆技术进步的驱动下及本土化供应保障、产业链自立自强的引导下，作为晶圆制造中保障产线稳定运行和产品良率的关键基础设施，工艺排气系统将迎来长期成长机遇。

(3) 全球化布局扩大市场份额

发行人发挥在先进材料应用技术、专利化高性能产品设计和高一致性供应能力等方面的差异化优势，进一步拓展国际主流半导体厂商客户群体，提升境外业务盈利贡献，形成“技术升级带来市场份额，市场份额提升盈利水平、盈利水平反哺技术升级”的良性循环。

2、先发优势、创新驱动与品牌价值协同助推，促进收入规模持续增长

(1) 下游产业扩展加快，发行人先发优势凸显

发行人是国内最早进入半导体工艺排气系统领域的本土企业，依托核心技术，进入了国内外主流晶圆厂的供应链体系，并保持长期稳定合作。发行人历史上供应或服务的规模化晶圆厂项目众多，该等项目经验及晶圆厂中稳定运行的产品及

系统共同为发行人积累了技术经验、建立了客户信任、构筑了品牌壁垒。

晶圆厂在推进技术升级和工艺优化时，通常希望将可控因素做到极致，因此会将建设先行、缺陷多样化且难归因的工艺排气系统工作交付给技术及工艺稳定性、历史业绩、品牌口碑较好的服务商。在多个行业标杆项目中积累的经验使发行人充分理解业主生产系统对于工艺排气的具体需求、技术难点，更容易获得业主青睐，并形成正向循环。

晶圆厂的建设具有很强的时效性，原因是晶圆制造的工艺迭代速度较快、晶圆市场下游需求存在周期性。因此，在多年的行业深耕中，发行人高一致性、高质量的规模化交付能力亦构成发行人的核心竞争优势，尤其是在行业需求旺盛、多家晶圆厂同时扩产时，该等优势更为突出。

(2) 发行人坚持以创新适配半导体工艺技术迭代

随着半导体先进制程的技术迭代越来越快，先进制程对工艺排气系统的气密性、耐腐蚀性、稳定性等也提出了更高的要求。发行人坚持以技术创新为核心驱动，一是注重技术积累，积极参与先进制程和标杆项目，关注需求反馈和技术难点，与客户协同解决问题，积累技术底蕴；二是加大研发投入，报告期内发行人研发投入分别为 1,676.10 万元、1,993.27 万元和 2,225.94 万元，保持稳定增长。发行人重视研发成果转化，积极推动新技术、新产品进入市场。

在技术驱动的战略下，发行人持续深耕工艺排气系统的核心技术，以更高的安全性和稳定性标准，将半导体生产环境端的缺陷来源最小化，助力我国半导体产线的安全升级。

(3) 品牌价值逐步体现，为集中差异化战略奠定基础

发行人经过多年深耕，其自主品牌“点夺（DIANDUO）”已积累较高的境内客户认可度，是进一步增强客户黏性、获取产品导入机会的重要基础。未来发行人将进一步发挥自身在半导体行业的先发优势，继续聚焦于半导体工艺排气系统市场，培育和维系品牌影响力。

八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明

保荐机构依据《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及规范性文件的要求，对发行人是否符合创业板上市条件进行了逐项核查，具体说明如下：

（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件

1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

本保荐机构依据《证券法》第十二条关于首次公开发行新股的条件，对发行人的情况进行逐项核查，并确认：

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等内部控制制度以及本保荐机构的适当核查，发行人已依法建立了包含股东会、董事会（审计委员会）、独立董事、董事会秘书等的公司治理体系。发行人目前有 5 名董事，其中 2 名为发行人聘任的独立董事；董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会；发行人不设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

根据本保荐机构核查以及发行人的说明、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》，发行人自股份公司设立后股东会、董事会能够依法召开，运作规范；股东会、董事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（2）发行人具有持续经营能力

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z3723 号），2023 年度、2024 年度及 2025 年度，发行人归属于母公司

股东的净利润分别为 7,606.03 万元、10,268.33 万元及 11,771.22 万元，扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别为 7,742.42 万元、10,281.03 万元、12,601.92 万元，具有持续经营能力，财务状况良好，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人最近三年的财务报告出具了标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2026]230Z3723 号），符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

保荐机构获取了发行人律师出具的法律意见书、境外律师针对境外主体出具的法律意见书、公安机关出具的无犯罪记录证明，获取了发行人及其控股股东、实际控制人出具的访谈记录、调查问卷，并结合企业及个人信用报告及保荐机构公开网络核查结果等。经核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（5）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

经核查，发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

2、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明

（1）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算

保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、整体变更为股份公司过程中的股东会决议、发起人协议、发起人的营业执照、验资报告、审计报告、评估报告等相

关资料。发行人前身点夺有限成立于 2010 年 3 月 26 日。2025 年 11 月 26 日，点夺有限以经审计的账面净资产折股整体变更为发行人，自点夺有限成立以来，发行人已持续经营超过 3 年。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

(2) 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告

保荐机构查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z3723 号）和无保留意见的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]230Z3724 号），查阅了发行人的财务管理制度、原始财务报表、内部控制相关凭证和文件等资料，确认发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。保荐机构确认发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

(3) 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

发行人资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，符合《首次公开发行股票注册管理办法》的相关规定。

发行人的主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，报告期内没有重大不利变化。

发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重

大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，发行人涉及的诉讼系正常经营活动过程中产生，涉及金额及占比较低，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(4) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

报告期内，发行人独立董事徐涛曾被采取行政监管措施，但该等监管措施不属于《中华人民共和国行政处罚法》规定的行政处罚；不属于重大失信行为；不属于《公司法》第一百七十八条规定的不得担任发行人董事情形；不属于《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条规定的“董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见”的情形；不属于《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第十四条第一款第（二）项所列的被中国证监会采取认定为不适当人选等相关措施尚未解除的情形。徐涛被北京证监局采取行政监管措施不影响其担任发行人独立董事的资格。

除上述情形外，发行人董事、审计委员会成员、高级管理人员及其他核心人员最近三年内未受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施，亦不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况。

(二) 发行后股本总额不低于 3,000 万元

发行人本次发行前股本总额为 6,899.79 万股。本次拟公开发行股票为不超过 2,300 万股，本次发行后总股本不超过 9,199.79 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。因此，发行后的股本总额不低于 3,000 万元。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

发行人本次公开发行 2,300 万股，本次发行后股本不超过 9,199.79 万股，公开发行股份达到发行人股份总数的 25% 以上。

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

发行人选择适用的上市标准为《上市规则》第二章 2.1.2 中规定的（一）项标准，即：“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”。

根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z3723 号），发行人 2024 年度、2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为 10,268.33 万元和 11,771.22 万元。发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，满足前述上市标准。

九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

本保荐机构对发行人持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：

主要事项	具体计划
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

主要事项	具体计划
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理办法》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	1、督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员列席发行人的股东会、董事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见； 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员定期对发行人进行实地专项核查。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定； 2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解释或出具依据。
(四) 其他安排	与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《公司法》《上市公司治理准则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定。

十、其他说明事项

无。

十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论

保荐机构已根据法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发

行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构兴业证券认为：发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。兴业证券同意推荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏点夺技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人：

(无)

保荐代表人：

李立鸿

李立鸿

谢弘扬

谢弘扬

内核负责人：

谢威

谢威

保荐业务负责人：

孔祥杰

孔祥杰

保荐机构法定代表人：

苏军良

苏军良

保荐机构：



兴业证券股份有限公司

2026年6月28日